

Noritake

100年の研削技術を、次世代半導体へ。

ノリタケの半導体向け技術・製品を会場でぜひご覧ください

SEMICON[®]JAPAN

次世代デバイス材料加工を支える実測データを公開！

2025年12月17日(水)～19日(金)

10:00～17:00

東京ビッグサイト

〒135-0063 東京都江東区有明 3-11-1

TEL: 03-5530-1111 (代表)

ノリタケ株式会社 東5 ホール E5437

SEMICON Japan 2025 は来場事前登録制ですので、ご来場前に公式 WEB サイトで来場登録（無料）をお願いします ▶



ご挨拶

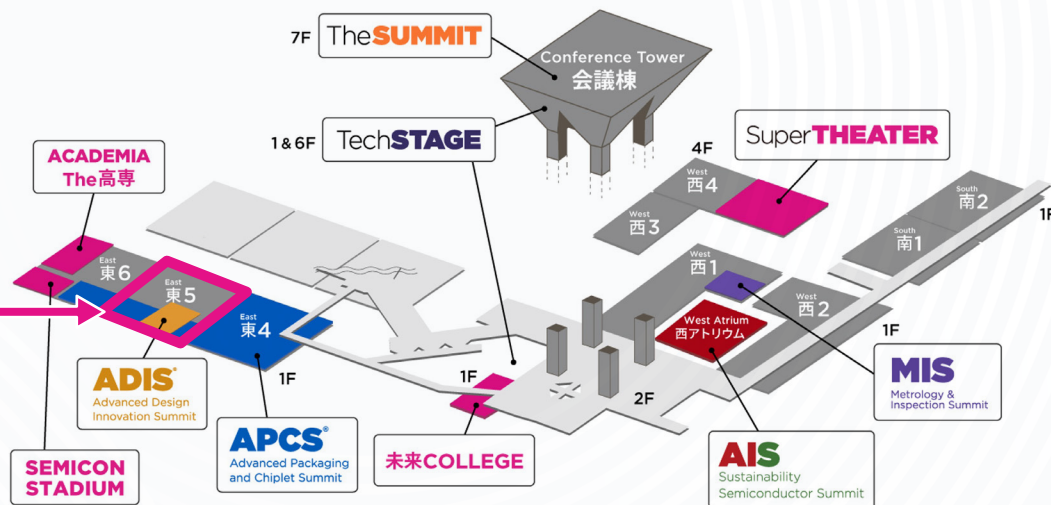
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社ではこのたび「SEMICON Japan 2025」に出展する運びとなりました。
「削る力・磨く技・支える濾過」をテーマに、お客さまのお役に立てる商品を展示いたします。
この機会にぜひご来場賜り、ご高覧いただきたくご案内申し上げます。

敬具

2025 年 11 月
ノリタケ株式会社

取締役 専務執行役員
工業機材事業本部長 前田 智朗

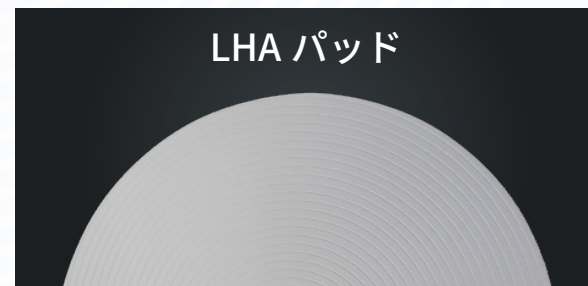
会場MAP



主な出展製品



SiC ウエハー平面研削・BG ホイール。独自の結合剤によって摩耗率を低減させコスト低減に貢献します。



SiC ウエハー CMP 用パッド（LHA パッド）。他社にはない砥粒内包型パッドによってスラリー不要で研磨可能であるため、コストと環境負荷の低減に貢献します。